

至索®1U2S高密度服务器

QR8218G3



产品简介

QR8218G3作为新一代1U规格的双路计算平台，支持英特尔®至强®6SP全系列CPU，匹配优化散热调控策略，不仅释放出卓越的计算效能，更在1U空间内实现了32个E1.S接口，达成512TB的全闪配置，为存储融合场景提供了强大支撑，尤其擅长处理数据密集型、低延迟、高吞吐的多元化工作负载。

产品特性

卓越性能 快速响应

- 高密1U空间实现风冷环境，即最大可集成两颗TDP高达500W的英特尔第六代至强可扩展处理器，整机核心密度提升2.25倍，云计算性能跃升2.38倍
- 采用全闪设计，32个PCIe 5.0 E1.s与CPU直连，使存储单元总容量突破512TB，理论带宽高达300GB/s，满足大容量低延时极致性能热数据处理需求

极致扩展 散热无忧

- 支持前维护架构，1U空间可支持7个PCIe 5.0 扩展槽，其扩展能力可与通用2U机型相媲美
- 引入多维协同冷却系统，涵盖高效EVAC、改良风道布局与冷板式液冷技术，整机冷却性能提升17%，保障持续高性能运行

智能安全 极致可靠

- 搭配内存故障“预诊愈”、开机3s智能控温、固件无感升级、主板故障噪音ns级定位等智能运维技术，快速精准定位故障源，有效避免宕机风险，提升服务器可靠性
- 全面切换开源稳定的OpenBMC架构，支持用户按需定制管理模块化功能，提升运维灵活性
- 整机可达25w小时MTBF，最大程度保障业务的可靠性

机型详细说明

产品型号	维护设计	散热方案
QR8218-T3-ARX0	后出线	风冷
QR8218-T3-AFX0	前出线	风冷
QR8218-T3-CRX0	后出线	冷板式液冷

产品规格

功能部件	技术规格	
规格	1U机架式服务器	
处理器	可搭配1或2个英特尔®至强®6代可扩展处理器, SRF：单个处理器配备多达144核/144线程	GNR：单个处理器配备多达86核/172线程
内存	最多支持32条DDR5 DIMM插槽，速率最高支持6400MT/s 可支持RDIMM插槽，SP P-core模式下可支持16条8000MT/s MCR内存	
	后维护配置	
	前置：最多12*2.5 SFF、4*3.5 LFF+4* E3.5 SSD、32*E1.5 SSD	
	后置：支持多达2*2.5 SFF	
存储	内置：最大支持1*TF卡、2*SATA M.2或NVMe M.2	
	前维护配置	
	前置：支持多达3*E3.5 SSD（2T/1T）、4*2.5 SFF、12*E1.5 SSD	
	内置：最大支持1*TF卡、最大支持2*SATA M.2或NVMe M.2	
RAID能力	支持RAID0, 1, 1E, 10, 5, 50, 6, 60 etc.	
	后维护配置	
	可支持≤7个扩展槽位，前窗2卡，后窗3卡及2个热插拔OCP 3.0	
PCIe扩展能力	液冷配置最大支持5个PCIe扩展槽位，包括1个热拔插OCP 3.0	
	前维护配置	
	可支持≤7个扩展槽位，前窗2卡，1个热插拔OCP3.0，后窗2卡及2个热插拔OCP 3.0	
管理网络	配备1个独立的1000Mbps网络接口，专用于IPMI的远程管理	
	后维护配置	
	前置：1*USB 2.0接口，1*USB 3.0接口，1*DB15 VGA接口， 1*Type-C接口（后维护配置）或1*RJ45（前维护配置）	
管理接口	后置：2*USB 3.0接口，1*DB15 VGA接口，1*RJ45管理网口	
	内置：1*USB 3.0接口	
散热	支持8个热插拔N+1冗余双转子风扇	
电源	最高可支持3200W 热插拔冗余CRPS标准铂金/钛金电源	
管理功能	支持双因素认证 开箱警告 安全面板 功耗封顶 TPM 2.0 BMC/BIOS芯片级冗余 内存故障预警 智能故障诊断模块 固件智能升级及其他	
操作系统	Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise USE Linux Enterprise Server CentOS及其他	
机箱尺寸	含挂耳： 高43.05mm 宽482mm 深810/880mm	不含挂耳： 高43.05mm 宽43.05mm 深780mm/850mm
重量与温度	满配≤29kg 5°C- 50°C	